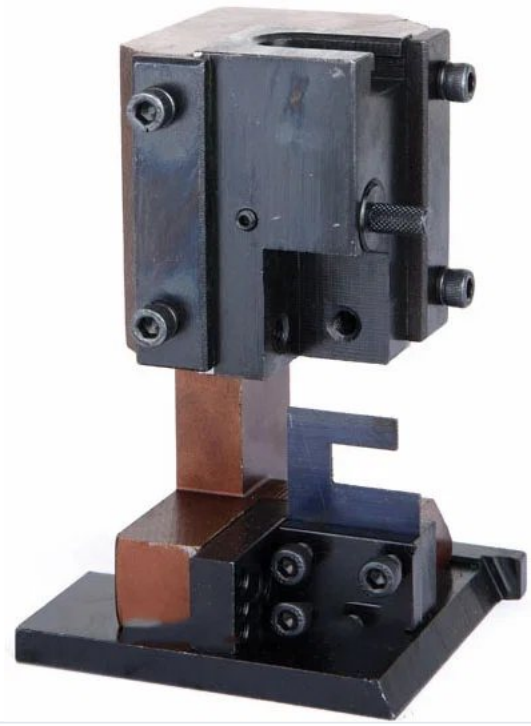
OTP 방사형 단말 압착 금형 애플리케이터용 JW-AP02

Model No. JW-AP02



SPECIFICATIONS

JW-AP02는 OTP 단말 애플리케이터에 사용하는 OTP 방사형 단말 압착 금형이다. 스트립이 애플리케이터로 공급되는 동안 다이가 배럴 주위로 방사 방향으로 닫히며, 케이블 하네스 제조의 전선 단말 양산 압착에 사용된다.

방사형 다이는 배럴을 한쪽에서 접는 대신 중심선을 기준으로 두 압착 플랭크를 대칭으로 닫으므로 양쪽 벽의 롤인이 균일하다. 본체는 측면에 조정 노브가 있는 좁은 단일 블록이어서, 베이스에 장착한 상태로 압착 높이를 다듬을 수 있다.

단말 도면이 횡방향이 아닌 방사형 압착을 요구하는 경우에 규정되며, 횡방향 금형과 베이스 • 램 인터페이스를 공유해 같은 스테이션에서 교체 사용이 가능하다.

주요 특징

1. 방사형 다이 형식으로 압착 플랭크가 배럴 중심선을 기준으로 대칭으로 닫힌다.

2. 좁은 단일 블록 본체로 넓은 횡방향 다이가 인접 툴링과 간섭되는 스테이션에 적합하다.

3. 측면 너얼링 조정 노브로 압착 높이를 애플리케이터 장착 상태에서 조정한다.

4. 압착 조를 전면 소켓 헤드 나사로 고정해 본체를 분해하지 않고 교체할 수 있다.

5. 애플리케이터 베드 정렬용 슬롯 장착공이 있는 가공 베이스 플랜지.

6. OTP 단말 애플리케이터에 기계측 개조 없이 직접 장착된다.

기술 사양

항목	사양
모델	JW-AP02
금형 형식	OTP 방사형 단말 압착 금형

항목	사양
압착 방향	방사형
사용처	OTP 단말 애플리케이터
적용 분야	전선 단말 압착

적용 분야

— 오픈 배럴 전선 단말의 방사형 압착용으로 설정된 OTP 단말 애플리케이터

— 단말 사양이 방사형 롤 압착을 요구하는 케이블 하네스 생산

— 벤치 애플리케이터에서 1회 스트로크로 절연부와 도체부를 함께 압착

— 횡방향 금형을 쓰던 애플리케이터에 동일 베이스로 방사형 다이를 개조 장착

— 심을 넣지 않고 기계에서 압착 높이를 조정하는 중소 배치 운전

